

# — EIAK 소식 —

## 상공자원부장관 초청 전자업계 간담회 개최



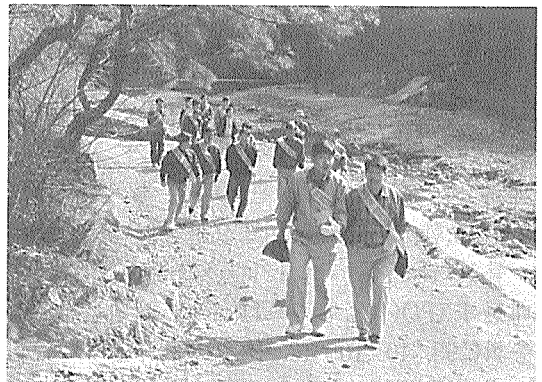
본회는 지난 3월 18일 상의클럽에서 상공자원부 김철수 장관을 초청, 전자업계 간담회를 개최했다. 본회 구자학 회장 등 전자업계 대표 20여명이 참석한 이날 간담회에서 김철수 상공자원부 장관은 국내 전자정보산업은 총수출의 28%를 차지하는 최대 수출산업으로서 경제성장과 국가경쟁력을 좌우하는 전략산업이라고 전제, 전자정보산업의 활성화를 위한 세부계획을 마련중이라고 밝혔다. 또한 컴퓨터 구매제도와 관련 현행 최저가 낙찰제도가 적합하지 않다는 데 관계부처가 의견을 같이하고 있고 종합낙찰제 적용을 위한 구체적인 방안을 연구하고 있다고 말했다. 또 가전제품 폐기물 예치금 부과제도 개선 건의와 관련 오는 6월말로 예정된 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」의 시행령 제정시 환경처 등 관계부처와 협의해 업계의 부담을 최소화하도록 하겠다고 밝혔다.

또한 6월로 만료되는 임시투자세액 공제기간을 연장 적용하고 공제대상도 확대해야 한다는 우리 업계의 건의에 대해서 임시투자세액 공제제도의 적용시한을 금년말까지로 연장하는 방안을 재무부와 협의 중에 있으나 대상 품목 확대문제는 무역수지를 악화시키고 국산 설비의 투자촉진에도 문제가 있어 곤란하다고 밝혔다.

이 밖에 병역특례기술인력 확대 건의에 대해선 전체 병역특례 요원의 규모에 제약이 있기 때문에 어려움이 있으나 대책을 강구하겠다고 밝혔다.

〈자세한 내용은 2Page를 참고〉

## 식목일, 전임직원 자연보호운동 전개



본회는 지난 4월 5일 식목일을 맞아 경기도 청계산에서 자연보호운동을 벌였다.

이날 행사에는 전임직원이 참석 「자연을 깨

끗하고 푸르게」라는 어깨띠를 두르고 등산로를 따라 정상까지 오르면서 널려져 있는 쓰레기를 말끔히 수거했다.

## 제24회 한국전자전 참가신청 접수시작



본회는 오늘 10월 9일부터 14일까지(6일간) 한국종합전시장에서 개최되는 제24회 한국전자전람회(KES '93) 국내업체의 참가신청을 4월 1일부터 접수를 시작했다. 상당수의 참가 희망업체들이 보다 유리한 부스위치를 선점하기 위해 전년도에 비해 접수시작 9시 이전부터 많은 업체가 대기하고 있어, 추첨으로 접수순번을 부여하고 있으며, 추후 접수순번에 따라 선택의 우선권이 주어지고 있다.

국내 각종 전시회 중 제일 큰 규모로 개최되는 총전시면적 27,252m(8,260평)에 18개국 550여 업체(국내 350, 국외 200)가 참가하는 국제적인 행사로서 참관인원은 외국인 5,500명을 포함, 총 260,000여명으로 예상하고 있다.

특히 금년에는 전시기간 중 국제적 행사인 대전 EXPO('93. 8. 7~11. 7)와 세계무역센터 총회('93. 10. 10~10. 13)가 개최되어 그 어느해보다 세계 각국에 한국의 전자제품을 널리 소개할 수 있는 철호의 기회가 될 것이며, 인접 국가인 일본, 대만, 홍콩의 전자전 일정과 맞물려 동시에 개최되므로 예년에 비하여

많은 바이어가 내방할 것으로 기대되고 있다.

한편 지난 3월 2일부터 외국업체 참가신청을 접수하고 있으며 국내외 업체 접수마감은 오는 5월 10일(월)까지 이다.

〈문의처: 본회 전시과(553-8725, 553-0941/7)〉

## 한·EC 가전산업협의회 개최

본회는 지난 4월 1일 벨기에 부뤼셀에서 한·EC 가전산업협의를 개최했다.

이번 한·EC가전산업협의회는 본회 한규완 상근부회장을 단장으로 삼성전자(주) 등 5개사가 참여했으며 EC측에서는 R. E. Norman EACEM의 Thomson C. E 회장 등 9명이 참석하였는데, 한국의 산업정책, 한·EC가전제품 교역 현황, 시장접근 문제, 제3국 공동진출 방안, 산업협력 등에 관한 의제를 가지고 한·EC간 협력을 심도있게 모색해 나아가기로 했다.

## 국내 이동통신산업 육성을 위한 애로건의

본회는 지난 3월 15일 국내 이동통신 산업 육성을 위한 당면 애로사항을 상공자원부 체신부, 관세청, 한국이동통신(주)에 건의했다.

이는 우리 이동통신산업이 국가경제, 사회발전과 국민생활에 기반이 되는 산업이며, 향후 고도정보화 사회에 있어서 중요 통신수단으로 이용됨에 따라, 세계적인 시장잠재력이 있고 수출고도화를 촉진시킬 수 있는 유망한 산업임을 감안, 최근 국내 이동통신산업이 가격 및 기술적으로 경쟁기반이 취약한 상태에서 수입품의 국내시장 잠식이 가속화되고 있고 선진국의 특허공세 등으로 인하여 해외

시장 진출에 어려움을 겪고 있어 여러가지 환경 및 제도적 요인에 대한 애로사항을 국내 이동통신산업의 육성차원에서 건의한 것이다. <자세한 내용은 15Page를 참조>

## 전자의료기기 검사 관련제도 개선 건의

본회는 지난 3월 11일 보사부에 전자의료기기 검사 관련제도 개선에 대한 건의를 했다.

이는 최근 전자산업이 국내의 무역환경으로 인하여 무역수지 적자를 면치 못하고 있는 가운데 전자의료기기 산업이 기술집약적이고 고부가가치 산업임을 감안, 수출시장 확대 노력에 심혈을 기울여 왔는데 국내 병원관계자들의 국산의료기기의 외면, 기술개발인력 및 자금부족, 검사제도의 어려움 등이 있었다. 이중 영업활동에 직접적인 영향을 미치는 국내 판매 전 시험검사 운용제도 및 제조업과 품목허가시 발생하는 임상시험에 있어서 전자의료기기 업계의 애로사항을 건의 한 것이다. <자세한 내용은 18page 참조>

## 튀니지아 투자유치 방한 사절단 본회 방문



본회는 지난 3월 29일 튀니지아 투자유치 방한 사절단의 예방을 받고 본회 한규완 부회장과 환담을 가졌다. 주한 튀니지아 대사(Salah B. Hannach), 튀니지아 상공차관(Brahm Kheli) 등 12명으로 구성된 사절단 일행은 본회와 양국의 산업협력방안에 대해 협의하였고 이 자리에서 본회의 소개와 한국의 전자공업 현황에 대해 설명을 하였으며 튀니지아 사절단원들은 우리 전자업체와의 합작투자 등에 깊은 관심을 보이고 이를 위한 본회의 협조를 요청했다.

## 전자부품산업협의회

**모** 터분과위원회(위원장 : 새한전자 정재선 회장)에서는 지난 3월 4일, 25일 본회 11층 회의실에서 삼성전기(주) 최 천 과장 등 수요업체 3개사와 동양정공(주) 권준혁 사장 등 공급업체 3개사가 참석하여 VCR용 Drum Motor의 P. G Magnet 등 소요부품 표준화 협의를 하였다.

**디** 스플레이분과위원회(위원장 : 삼성전관(주) 박경팔 사장)에서는 지난 2월 25일과 3월 19일(금) 금성사 박명호 실장 등 9명이 참석, 회의를 개최하고 32" Wide Vision의 브라운관용 Panel 등에 대한 표준화 협의를 하였다.

**부** 품산업협의회에서는 지난 2월 16일~2월 26일 주요 종합 가전업체 사업부서를 방문하여 '92년도 표준화 추진현황 설명 및 '93년도 Set업계간 추진할 표준화 대상과제 발굴을 실시하였으며 3월 18일에는 종합 가전 3사 표준화 실무 부서장 회의를 개최하여 표준화 관련 각사 정보를 교환하였다.

**변** 성기분과위원회(위원장 : 오성전자산업 (주) 유병화 사장)에서는 지난 3월 12일과 3월 30일 본회 회의실에서 삼성전기(주) 최대성 부장 등 6명이 참석하여 FBT용 Film Capacitor에 대한 표준화 협의를 하였다.

**센** 서분과위원회(위원장 : 계코전자(주) 홍기룡 사장)에서는 지난 3월 15일 본회 회의실에서 대우전자부품(주) 어관 과장 등 4명이 참석하여 NTC 써미스터의 시험방법중 저항-온도특성 검사 등 8개 항목에 대한 표준화 협의를 하였다.

**스** 피커분과위원회(위원장 : 기린전자(주) 이기방 사장)에서는 지난 3월 24일(주) 본회 회의실에서 북두 김한욱 부장 등 9명이 참석하여 스피커용 소모 부품 표준화 제정규격에 대한 협의와 '93년도 표준화 추진 대상 과제 발굴을 위한 협의를 하였다.

### 컴퓨터산업협의회

**컴** 퓨터주기판 분과위원회(위원장 : 태일정밀(주) 정강환 사장)는 지난 3월 23일 팔레스 호텔에서 태일정밀 등 11개사가 참석하는 동분과위원회를 개최하고 국내 생산이 불가능한 CPU에 영세율을 적용함으로써 주기판의 원가부담을 경감시켜 국제경쟁력을 제고할 수 있도록 CPU 관세면제를 건의하는 한편 컴퓨터산업에 국가공업규격(KS) 적용(안)에 대해 의견을 교환, 이의 적용은 중소기업차원에서 적기에 제품이 출하되지 못하는 등 여러가지 불합리한 요소가 많아 외국과의 경쟁력 저하 요인이 될 수 있음을 지적했다.

또한 컴퓨터 호환성 테스트에서는 컴퓨터 네트워킹화 할 수 있는 호환성 시험을 전자부품연구소와 EMI 검정기술시험연구소에 장비

를 추가 설치하여 실시하는 것이 바람직하다고 의견을 같이 했다.

**동** 산업협의회는 '92. 2월부터 PC 중간재 표준화 제정을 추진해 왔는데 그동안 PC 산업의 국제경쟁력의 약화, 핵심중간재의 비표준화 제품의 호환성, 확장성 미비, 산업표준화에 대한 인식제고와 업계의 협력분위기 확산 등을 위해 노력해 왔는데 PC 중간재 표준을 통하여 생산성 향상 및 품질개선, 기술축적과 기술확산, 거래비용의 절감, 산업조직의 효율성 제고에 중요한 역할을 할 것으로 보인다. '93년 4월 현재까지 PC중간재 표준화 현황은 다음과 같다.

#### <PC 중간재 표준화 추진 내용>

| 품목명   | 표준화 과제명          | 표준화 부문   |
|-------|------------------|--|
| 마더보드  | Slot형 마더보드       | 크기와 형태, 고정 Hole의 위치, Slot의 위치 및 형태, 전원 콘넥터의 모양 및 Pin 배열, Key Board용 콘넥터 및 기타 콘넥터의 각종 사양, 32Bit Slot의 모양,   |
|       | All-in-One형 마더보드 | 크기와 형태, 고정 Hole 및 수직 Slot의 위치, 기구물과 All-in-One형 마더보드의 장착, 전원 콘넥터의 모양 및 Pin 배열, KeyBoard 콘넥터 및 Port 위치, 기타 콘넥터, 수직 Slot Card의 위치 및 치수, Riser Card 콘넥의 Pin 배열, |
| 에드온카드 |                  | Bracket의 크기와 형태, PCB의 크기와 형태, Slot의 크기, Flat Cable 처리시 Pin 배열,   |
| Case  | Slot형 Case       | 에드온카드의 Bracket window Opening 폭, Rear부의 SMPS 고정 위치, 마더보드의 고정위치 및 방법, Case Harness, 전부품에 사용되는 색상,   |
|       | Slot형 Case       | 3.5"/5.25" Drive의 Window Opening 크기, 사용고정 나사, Bracket Window의 Opening Area 사양, Drive류의 확장 해체에 따른 Case 구조   |

| 품목명             | 표준화 과제명          | 표준화 부문   |
|-----------------|------------------|--|
|                 | All-in-One형 Case | 뒷면 Bracket 크기와 형태, SMPS 고정위치, 마더보드 고정위치, Case Harness, 전부품에 사용되는 색상, 3.5"/5.25" Drive의 Window Opening 크기, 고정나사, Bracket Window의 Opening Area 사양, Drive류의 확장, 해체에 따른 Case 구조  |
| SMPS            | A Type SMPS      | 고정위치와 방법, 방열 Fan의 엠보싱 높이, Inlet/Outlet, 전압선택 스위치, 방열 Fan의 위치, 크기 및 형태, 전원 Switch Cable 출구 위치, DC Output Cable 출구 위치, 밀면 고정 사각 구멍, Drive용 Power Cable의 길이, Drive Power용 콘넥터 수, 용량별 전압 및 전류, Harness 색상, AC Outlet, 전원 Switch Cable 길이, Push Type 전원 Switch 사양         |
| SMPS            | B Type SMPS      | 고정위치와 방법, 방열 Fan에는 Fan Guard를 적용, Inlet/Outlet, 전압선택 스위치, 방열 Fan의 위치, B Type SMPS의 크기 및 형태, 전원 Switch Cable 출구 위치, DC Outlet Cable 출구 위치, Drive용 Power Cable의 길이, Drive Power용 콘넥터 수, 용량별 전압 및 전류, Harness 색상, AC Outlet, 전원 Switch Cable 길이, Push Type 전원 Switch 사양 |
| KeyBoard        |                  | Cable 길이, Cable 출구 위치, Plug Jack의 사양, Cable 및 Cable의 Molding부 Color, Packing Box의 크기,  |
| CRT-Monitor     |                  | Singal Cable의 길이, Power Cable, 콘넥터 Shell의 Molding 크기, D-Sub 콘넥터의 6각 Screw 사양   |
| FDD/CD-ROM/MODD |                  | Front Bezel 크기, 바닥면에서 Side Mounting Hole의 높이, 기타 Mountion Hole 및 크기, Front Bezel의 좌우 치우침,  |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
|  | HDD(Hard Disk Drive) | 3.5" HDD의 Singnal Connector, 3.5" HDD의 Mounting Hole 위치 |
|--|----------------------|---|

## HA산업협의회

**동** 협의회는 지난 3월 4, 11, 19, 25일 4일간 Home Bus System 표준규격 초안 제정 작업을 삼성전자(주) 이창우 수석연구원 등 10개사가 추진. Command 할당, System 공통 Command 검토, 통신 Syquence 검토, Documentation 진행 등 검토작업을 벌여왔다.

## CATV기기산업협의회

**동** 협의회(회장: 동양텔레콤(주) 배석채 사장)는 지난 3월 9일 전자부품종합기술 연구소에서 한국형 CATV 공동개발 전체회의를 개최하고 가입자관리시스템 개발사업 대표간사를 선임하고 KCATV연구과제 추진계획을 논의했다.

**방** 송분과위원회는 지난 3월 8일, 23일 1, 2차 동분과위원회를 개최하고 방송국표준모델(안) 구성을 위한 협의와 동(안)의 설명 및 추진방향을 논의했다.

**동** 협의회는 지난 3월 17일 팔레스 호텔에서 한국전자 문기대 사장 등 18명이 참석, '93 서울 국제유선방송 시스템 전시회관련 조찬간담회를 개최하고 개별전시 참여 여부와 공동홍보관 구성을 위한 협의를 했다.